

4Q FY2024 IR

Disclaimer

본 자료는 재무제표 및 향후 전망에 관한 내용을 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

본 자료는 객관적 기준 등을 참고하여 작성하였으나 일부 예상, 전망 또는 주관적 판단에 의한 표현이 포함되어 있을 수 있고, 향후 환경의 변화, 상이한 데이터 집계기준 등에 의하여 본 자료와 일치하지 않은 다른 숫자와 해석이 도출 될 수도 있음을 인지하시기 바랍니다.

따라서 여기에 포함되어 있는 서술 정보만을 믿고 이 정보에만 의존한 투자결정을 내리지 말아야 하며, 투자 책임은 전적으로 투자자 자신에게 있음을 밝혀 드립니다.



Contents

- 2024년 4분기 실적요약
- 회사소개
- 경영환경 및 전망
- 별첨

The background of the slide is a high-resolution, close-up photograph of several disassembled smartphone chassis. The frames are arranged in a diagonal pattern across the slide. They are made of a light-colored, possibly aluminum or stainless steel, material. Various cutouts for the camera, speaker, and other components are visible. The lighting is soft and even, highlighting the metallic texture and the precision of the manufacturing.

STAGE 1

2024년 4분기 실적

24년 4분기 실적요약 (연결기준)

4분기 매출액 622억원 기록 하였으며 전년 동기 대비 26% 증가, 4분기 영업이익 32억원으로 전년 대비 18.5% 증가함 (YoY)

(단위: 억원)

구분	2023년 4Q	2024년 3Q	2024년 4Q	증감률	
				YoY	QoQ
매출액	493	923	622	26.2%	-32.6%
조립모듈	202	629	285	41.1%	-54.7%
기타	291	295	227	-22.0%	-23.1%
매출원가	421	737	547	29.9%	-25.8%
매출총이익	71	186	76	7.0%	-59.1%
판관비	44	117	43	68.2%	-36.8%
영업이익	27	69	32	18.5%	-53.6%
영업이익률	5.5%	7.5%	5.2%	-0.3%p	-2.3%p
당기순이익	-56	44	42	흑자전환	-4.5%
당기순이익률	-11.5%	4.7%	6.7%	18.2%p	2.0%p

2024년 실적요약 (연결기준)

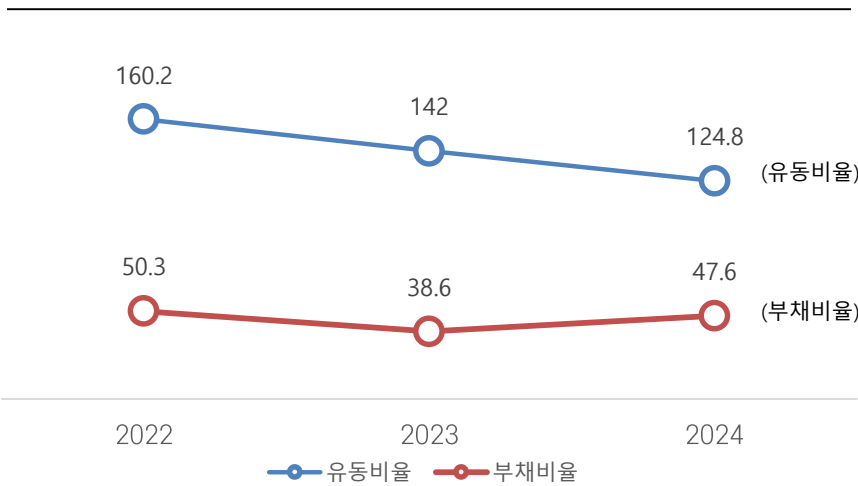
2024년 매출액은 3,110억, 영업이익은 219억을 기록하였으며 유동비율 124.8%, 부채비율 47.6%를 기록하여 전년대비 실적은 다소 감소하였으나 기업의 안정성은 지속 유지중

■ 요약 손익계산서

(단위: 억원)

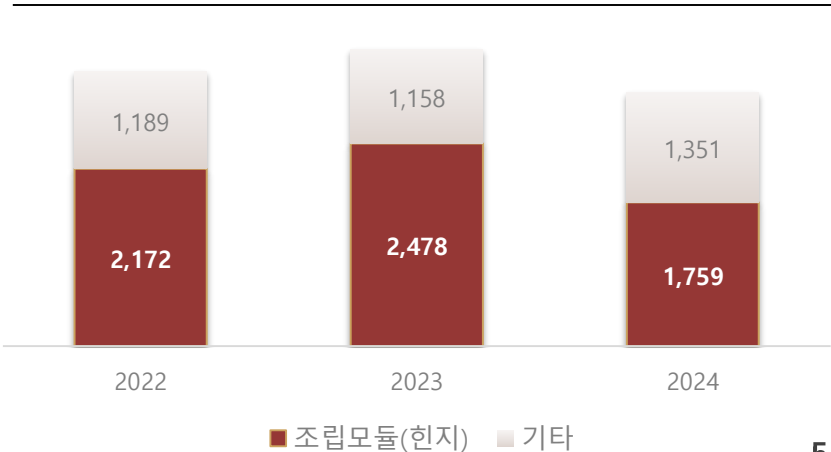
	2022	2023	2024	증감률 YoY
매출액	3,361	3,636	3,110	-14.5%
조립모듈(хин지)	2,172	2,478	1,759	-29.0%
기타	1,189	1,158	1,351	16.7%
매출원가	2,699	2,905	2,606	-10.3%
매출총이익	662	731	504	-31.1%
판관비	309	395	286	-27.6%
영업이익	353	336	219	-34.8%
영업이익률	10.5%	9.2%	7.0%	-2.2%p
EVITDA	537	505	419	-17%
EV/EVITDA(%)	16.0%	13.9%	13.5%	-0.4%p
당기순이익	250	309	213	-31.1%
당기순이익률	7.4%	8.5%	6.9%	-1.7%p

■ 주요 재무비율



■ 매출구성 및 추이

(단위: 억원)

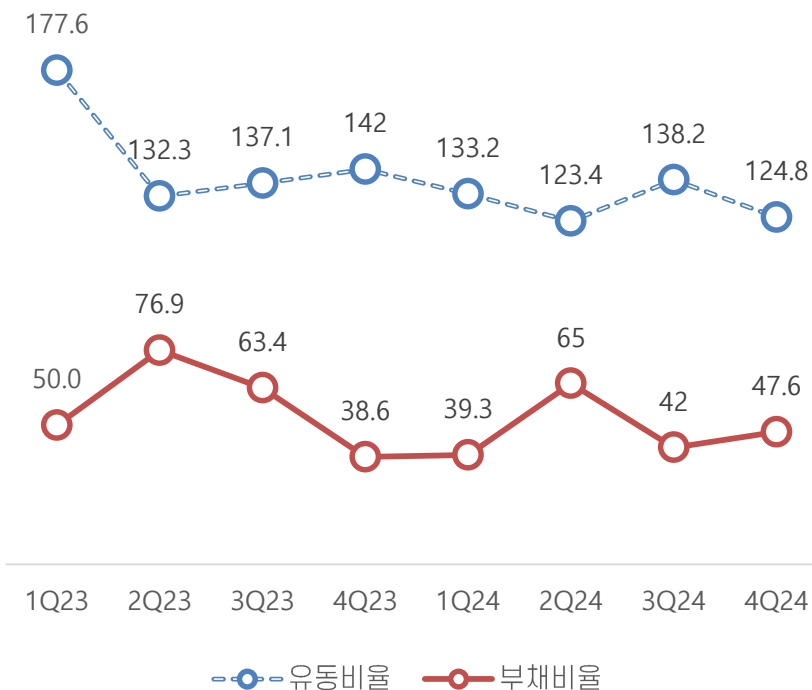


24년 4분기 실적요약

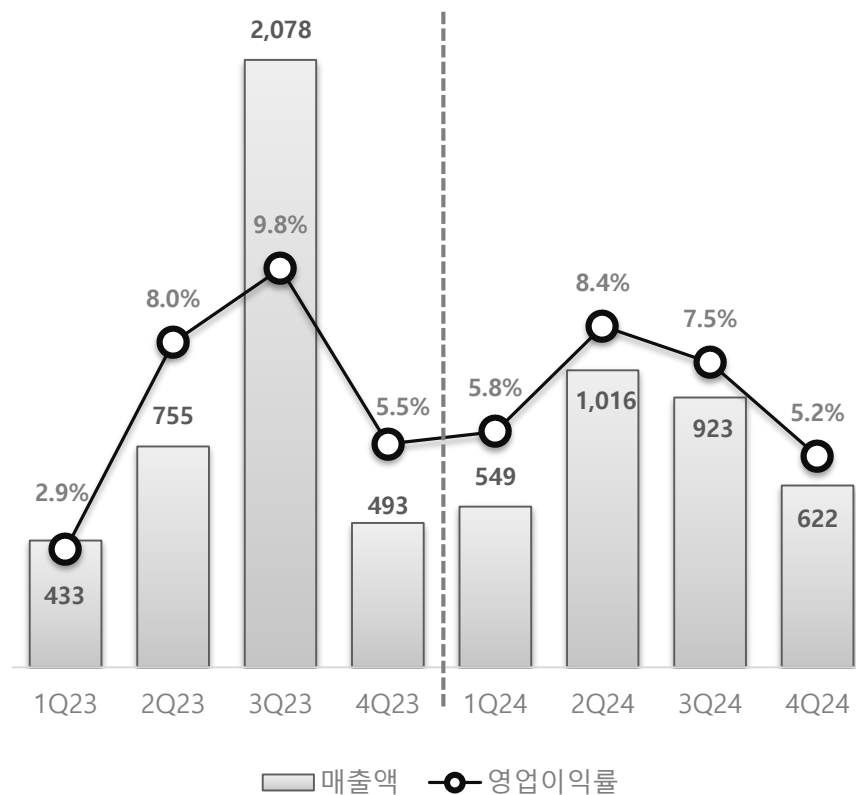
유동비율 125%, 부채비율 48%를 기록하면서 안정적으로 유지되고 있음

주요 재무비율

(단위 : %)



분기별 매출액 / 영업이익률 추이

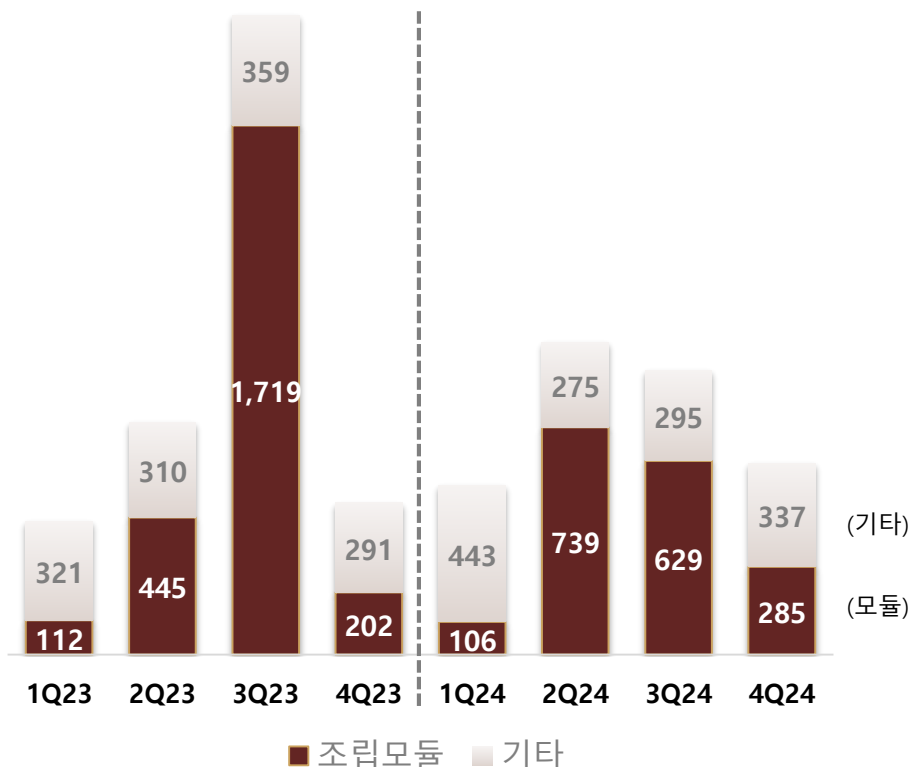


24년 4분기 실적요약 (연결기준)

조립모듈 매출 및 기타 매출 모두 소폭 전년 동기대비 소폭 상승하며 매출 기준 YoY 26% 성장을 기록함

■ 분기별 매출구성

(단위 : 억원)



■ 주요 사업현황 및 전망

① 조립모듈

- 4분기 계절적 비수기 영향으로 매출하락
- '24년대비 '25년은 힌지 폼팩터 변경 → 판가 상승 전망
- 새로운 힌지 폼팩터 확대
- 고객사 다변화 지속 추진

② 메탈케이스 / 기타

- 4분기 신규 Ti-IDC 양산 (S25)
- 갤럭시 S25 울트라 출하량 증가 전망 → Ti-IDC 매출 증가 전망
- '25년, 전장부품 (디스플레이 브라켓, 엔드플레이트) 매출기여
- 신규사업 지속 매출 증대 (통신장비, ATM 등)



STAGE 2

회사소개

1. 주요사업장

1) 국가별

KH바텍은 국내에는 서울사무소와 구미 본사 및 2공장을 운영 중에 있으며 해외로는 중국, 베트남, 인도에 해외법인을 운영하고 있음



1. 주요사업장

2) 지역별

KH바텍은 국내에는 구미본사와 서울사무소를 운영 중에 있으며 해외로는 중국(혜주), 베트남 (타이응웬,박닌), 인도(그레이트노이다)에 해외법인을 운영하고 있으며, 25년 4월 가동예정인 타이응웬 VC전용공장을 추가 건설중에 있음



한국 (서울, 구미)

설립일 : 1992년11월
직원수 : 181명
대지 : 4,500평
건평 : 3,000평



KHV 타이응웬

설립일 : 2023년 4월
직원수 : 314명
대지 : 37,000평
건평 : 16,000평



KHV 하노이
(박닌 포함)

설립일 : 2018년 1월
직원수 : 1,998명
대지 : 15,000평
건평 : 11,450평



KHV 혜주

설립일 : 2010년 6월
직원수 : 111명
대지 : 24,000평
건평 : 20,000평



KHV 인도

설립일 : 2019년 3월
직원수 : 1,257명
대지 : 23,000평
건평 : 6,500평

2. 주요제품

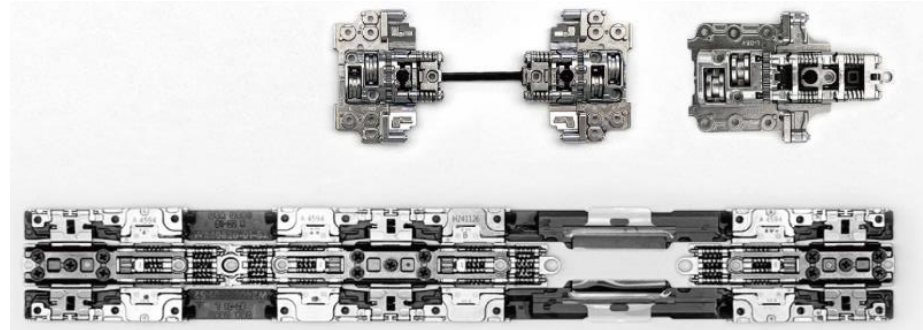
1) ICT제품

KH바텍은 빠르게 성장하는 폴더블 스마트폰의 핵심부품인 힌지를 생산하고 있으며, 메탈케이스 제품은 이미 세계 최고의 수준으로 인정받고 있음

Foldable Hinges

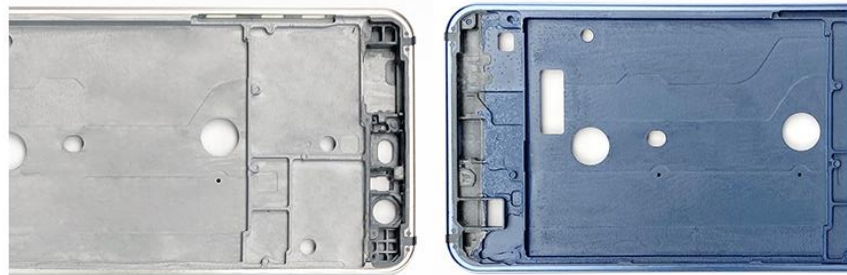
KH바텍은 독보적인 힌지 설계 능력, 금속분말 사출 성형(MIM) 기술, 조립기술을 바탕으로 폴더블 힌지를 생산하고 있음.

폴더블 힌지란, 폴더블 OLED를 기반으로 한 폴더블 폰의 화면을 접었다 펼 때의 패널이 맞닿는 충격을 최소화시켜 구동을 가능케 하며, 새로운 폼팩터 시대에 맞춰 폴더블 뿐만 아니라, Rollable, Slidable 등 다양하게 적용될 스마트폰의 핵심 부품임.



IDC (Insert Die-Casting)

금속 블록을 통째로 가공하는 공법을 탈피하여, 외장 면은 알루미늄 압출재, 스테인리스, 티타늄 등의 합금을 적용하여 아노다이징, 증착 등의 기술로 외장면을 처리하고, 내장 면은 알루미늄 다이캐스팅을 구현하여 블록을 통째로 가공하는 방식대비 절삭가공 시간을 획기적으로 줄인 KH바텍만의 독보적인 기술.



VAW(Value Added Welding)

당사가 자체 개발한 VAW(Value Added Welding) 기술은 Die-Casting 내장품과 알루미늄 외관용 케이스를 접합하는 기술로써 당사의 고유한 특허 기술임. VAW기술을 활용할 경우 생산비용과 생산 시간을 크게 단축 시킬 수 있어 국내외 고객들로부터 저가형 AI 케이스용 최상의 기술로 인정받고 있음.



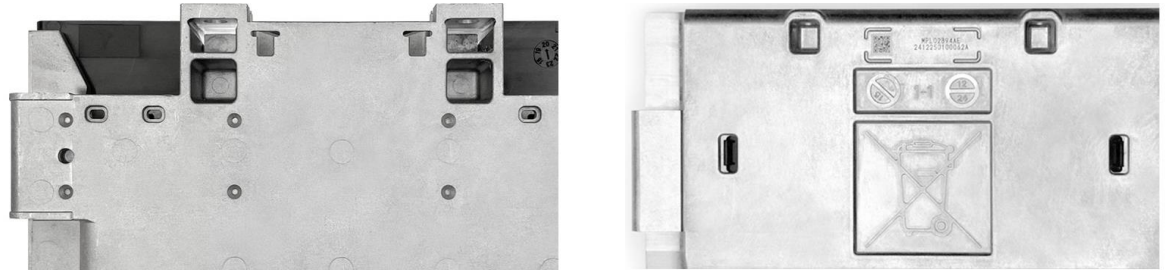
2. 주요제품

2) EV+전장품+로봇

KH바텍의 전기자동차용 END PLATE 및 전장품을 개발~제조를 하고 있으며, 로봇 및 열전달과 전자파차폐가 탁월한 네트워크 제품들로 사업모델이 확장되고 있음

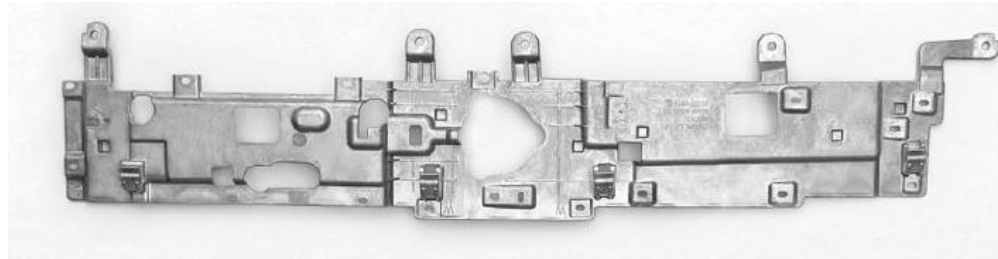
배터리 (END PLATE)

배터리 CELL을 내·외충격으로부터 보호하는 핵심 부품인 End Plate를 고진공 Die-Casting, Insert Die-Casting 기술로 자체개발하여 생산 중에 있음.



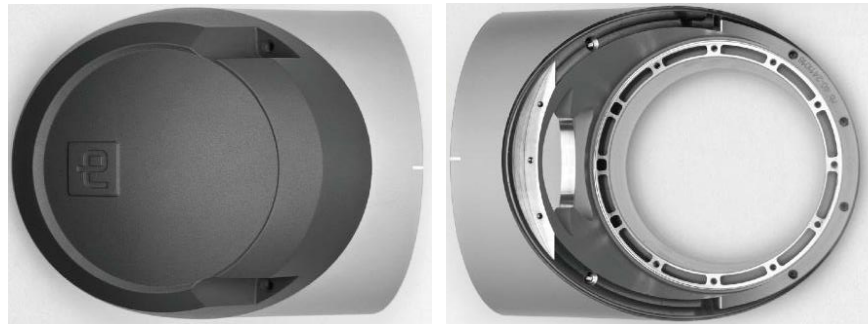
HEAT SINK & 기타

KH바텍은 소자의 열을 흡수하여 외부로 방출하는 알루미늄 HEAT SINK, DRL, RCL의 브래킷 부품을 생산하고 있음. 또한 다양한 전기차 디스플레이와 제어장치용 다이캐스팅 제품 개발과 생산에도 참여하여 미래를 확장 중.



ROBOT

KH바텍은 연평균 성장률이 30% 이상으로 예상되는 로봇산업 분야에 필요한 초정밀 기구물 개발에도 박차를 가하고 있음.
미래 산업현장에 필수적인 협동로봇의 부품을 필두로 하여 견고하면서도 가벼운 그리고 고신뢰성의 특화된 제품 분야로 진출하고 있음.





STAGE 3

경영환경 및 전망

1. 최근 업계 동향

최근 스마트폰 업계는 폴더블 스마트폰의 성장 및 스마트폰 메탈케이스의 적용확대가 기대 중이며 전장시장의 성장 역시 기대감이 커짐에 따라 KH바텍은 이에 맞는 솔루션을 적용 하고자 함

업계 기술 / 트렌드



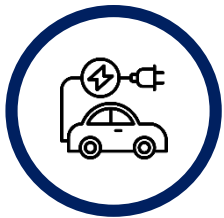
① 폴더블 스마트폰

- 국내 고객사의 폴더블 폰은 2019년 이래로 '24년 첫 역성장 예상되나,
- 중화권 업체들의 경쟁적인 신규제품 출시 및 북미 "A"사의 폴더블폰 기대
- 2027년 약 50백만대로 성장 전망 (메리츠 증권 추정)



② 메탈케이스의 확대

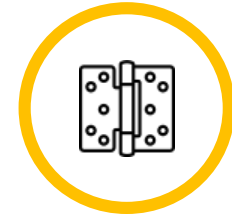
- 갤럭시 S24~S25 울트라 티타늄 케이스 적용 (적용 모델 확대 기대)
 - 휴대폰 업체들의 경쟁적인 티타늄 케이스 채용 증대
- 갤럭시 A시리즈 메탈케이스 채택 (A5) → A3확대 기대
- '24년 아이폰의 등장을 시작으로 스마트폰 수요 회복 기대



③ 전기차 + 전장

- 향후 전기차 침투율 확대 지속 전망 및 전장부품 가속화 기대
- 국내 주요 전장업체의 수주잔고 우상향 및 '25년부터 본격 매출반영
- 전장부품 시장이 '25년부터 스마트폰 부품 시장 추월 예상함

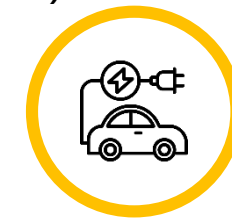
KHVATEC Solution



Foldable Hinge



Insert Die-Casting (IDC)
Value Added Welding (VAW)



D.B / E.P / M.M

※ D.B : Display Bracket
E.P : End Plate
M.M : Moving Mechanism

2. 폴더블 힌지

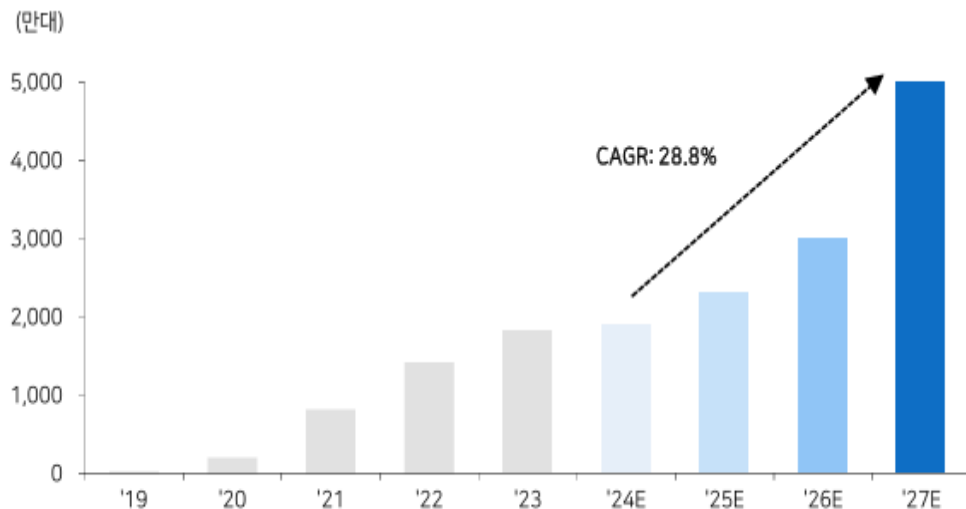
폴더블 힌지 시장은 '24년 정체기를 거쳐 25년 부터 향후 3년간 CAGR 28.8%의 성장이 기대되며 북미 "A"사의 시장 참여가 예상되는 26년 이후는 급격한 성장이 기대됨



KH바텍의 폴더블 힌지 강점

- Nokia등 힌지공급을 통해 쌓인 다양한 노하우 및 레퍼런스
- 선행개발부터 양산까지 전 프로세스에서 대응 가능
- Al, SUS, Ti 등 고객의 요구에 따른 다양한 금속원소재 가공 가능
- 최적의 폴딩감도, 다양한 디자인 등 고객의 니즈에 맞춤 설계제작 가능
- Global 최대 캐파 → 급증하는 고객 수요 대응 가능

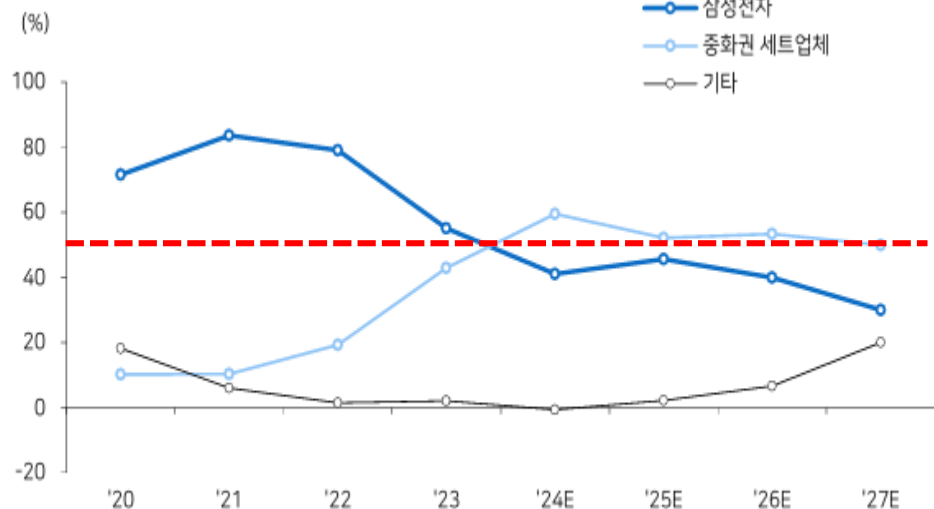
✓ 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량 예상 (향후 3년간 CAGR : 28.8%)



자료: 메리츠증권 리서치센터

WISE210

✓ 폴더블 스마트폰 시장 내 점유율 추이



자료: 메리츠증권 리서치센터

3. 스마트폰 수요 회복 및 메탈케이스 채택증가

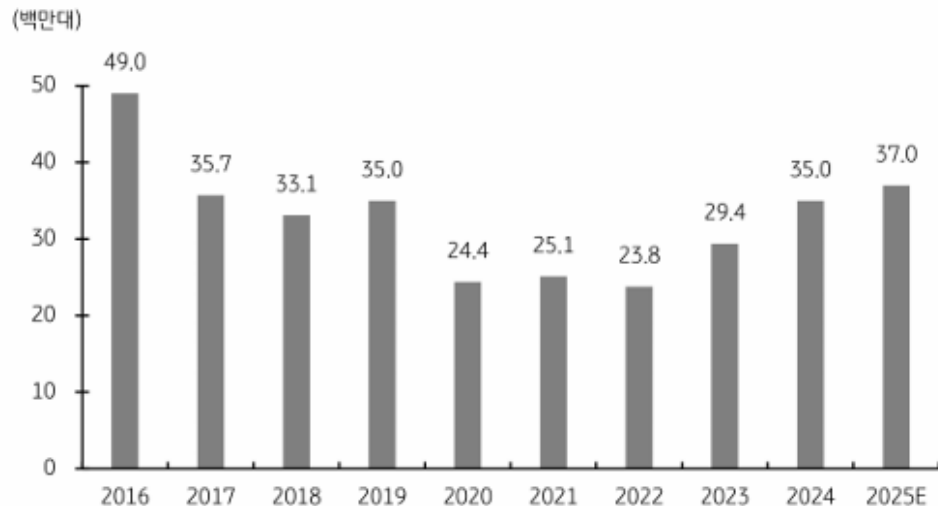
2024년부터 메탈케이스 채택이 증가되고 있으며, KH바텍은 IDC, VAW 공법으로 고가 및 저가 영역에 걸쳐 최적의 솔루션을 보유 중임



스마트폰 출하량 증가 및 메탈케이스 채택 확대

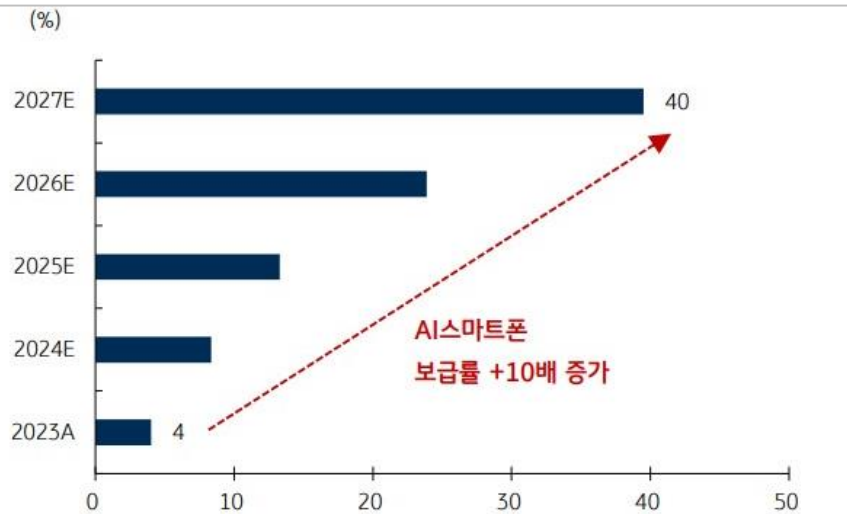
- 온디바이스 AI폰의 보급으로 갤럭시 S25 출하수량 증가 예상 : S25 37백만대 (전년대비 6%성장, KB증권) 예상됨
 - 하이엔드 모델에 티타늄 케이스의 적용 및 중저가 스마트폰에는 메탈케이스의 채택률이 증가 중
 - KH바텍은 2024년 부터 **IDC / VAW 솔루션 확보 → 티타늄 및 저가메탈케이스 솔루션 공급의 본격적 확대를 기대함**
- ※ IDC : Insert Die-Casting (이종접합 기술, 다이캐스팅 기반) / VAW : Value Added Welding (이종접합 기술, 용접기반)

✓ 삼성전자 갤럭시 S 판매량 추이



자료: Counterpoint Research, KB증권 추정

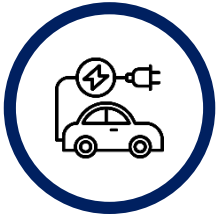
✓ 온디바이스 AI폰 보급



자료: Counterpoint Research, KB증권

4. 전기차(EV) + 전장 Biz

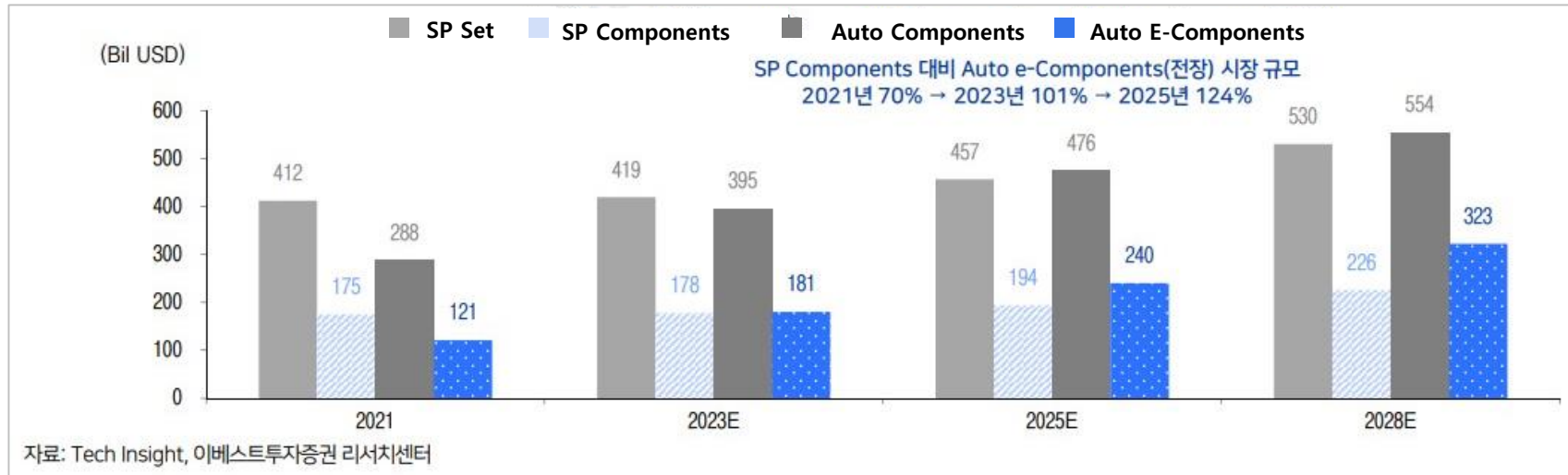
자동차의 전장화는 가속화 되고 있으며 KH바텍은 차별화된 다이캐스팅과 박막 기술력 및 힌지 메커니즘의 기술력을 활용하여 EV 및 전장 분야에서 기회를 창출 하고자 함



EV (전기차) + 전장 : KH바텍 3대 ITEM → 1) Display Bracket (Mg,Al,박막), 2) End Plate, 3) Moving Mechanism

- 자동차 전장부품 시장은 꾸준히 성장하여 25년부터는 전장 부품 시장이 스마트폰 부품 시장을 넘을 것으로 전망함
- 칩소몰딩을 활용한 Mg 디스플레이 브라켓(D/B) 영역에서 독보적인 기술 확보
- 진공/반응고 다이캐스팅, 가공관리를 활용한 End Plate 영역에서 월등한 제조수율 확보
- 폴더블 스마트폰에서 확장된 자동차 영역에서 차별화된 설계역량으로 Moving Mechanism 주도

☑ 자동차 부품 VS 스마트폰 시장 규모



5. ESG 경영 강화

ESG 경영의 중요성이 꾸준히 증가함에 따라, 2021년 KH바텍도 ESG 경영 도입을 선포하고 탄소배출감소, 지역사회 기여, 지배구조 개선 등 ESG 경영을 가속화 중임



KHV ESG 경영 강화

- ESG란? 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명경영을 고려해야 지속가능한 발전이 가능하다는 철학
- KH바텍은 2021년 본격적인 ESG 경영철학을 도입하기 시작
- 2025년에도 ESG경영은 더욱 중요한 키워드가 될 것으로 전망됨에 따라 KH바텍은 꾸준히 ESG 경영을 강화할 예정

✓ KH바텍의 ESG 주요활동

- '23~'24년 한국ESG 기준원 ESG 평가등급 A
- 주주가치 제고를 위한 현금배당 결정 (배당성향 30% ↑)
- '24년부터 반기배당 정책 도입
- KHV-ESG 환경부문 주요 목표 설정 및 실적 공개 (자사 홈페이지)
- 24년 태양광 발전(구미공장)으로 탄소중립에 기여
- 한국 및 해외법인 지역사회 나눔행사 참석 / 물품 후원

✓ 2025년 KH바텍 ESG 주요 목표

구분	내용
종합목표	CDP A등급 달성
E (환경)	■ 온실가스 배출 감소 / 재생에너지(전력) 사용
S (사회)	■ 중대재해처벌법 도입에 따른 공장 내 안전관리 강화 ■ 지역사회 기여 (문화예술나눔, 불우이웃돕기등)
G (지배구조)	■ 이사회 운영 강화 및 주주와의 소통 강화



STAGE 4

별첨

별첨 : 23~24년 분기별 실적요약 (연결기준)

■ 손익계산서

(단위: 억원)

구분	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
매출액	755	2,078	493	549	1,016	923	622
매출원가	637	1,633	421	455	867	736	547
매출총이익	118	445	71	94	148	186	76
판관비	58	240	44	62	63	117	74
영업이익	60	204	27	32	85	69	32
기타이익	41	74	-53	47	36	-16	84
기타손실	14	73	3	27	18	8	23
금융수익	30	9	6	5	3	3	3
금융원가	12	27	10	9	6	9	8
당기순이익	102	148	-56	36	91	44	42

■ 재무상태표

(단위: 억원)

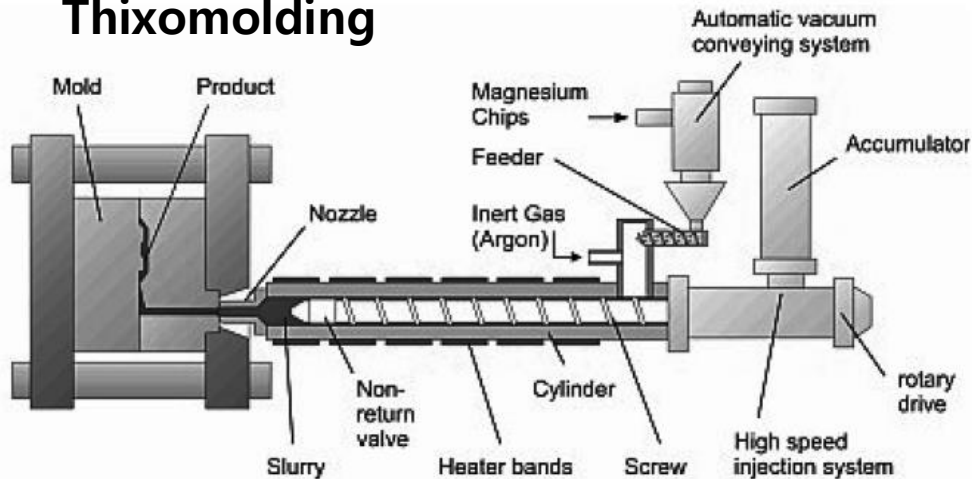
구분	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
유동자산	2,474	2,229	1,334	1,251	2,026	1,450	1,501
비유동자산	1,886	2,005	2,020	2,076	2,112	2,081	2,300
자산 총계	4,360	4,234	3,425	3,399	4,209	3,602	3,871
유동부채	1,870	1,626	939	939	1,641	1,049	1,203
비유동부채	25	17	16	19	1,805	1,727	45
부채총계	1,896	1,643	955	958	1,659	1,066	1,248
자본금	118	118	118	118	118	118	118
자본잉여금	583	633	634	634	634	634	634
기타자본 구성요소	-54	-119	-185	-161	-143	-190	-123
이익잉여금	1,828	1,970	1,915	1,862	1,953	1,986	2,007
자본총계	2,464	2,591	2,470	2,441	2,550	2,536	2,624

별첨 : 칩소몰딩 공법 비교

구분	Thixomolding (칩소몰딩)	Cold chamber
용융방식	가열 실린더 + 스크류	용해로 (용탕과 사출부가 분리)
용해온도	585~670	640~670
보호가스	Ar (아르곤가스)	SF6 (육불화황)
재료형태	Mg chip	잉곳
사출압력 (Mpa)	62~103	400~800 (고압)
특징	* 반응용 상태로 금형의 열충격 적음 → 금형수명 ↑ * 제품내부 조직이 치밀하고 미세기공이 현저히 적음 * 친환경 생산방식 : 전기료 ↓, 환경문제 유발하는 SF6無 * 고가의 칩형태 재료 필요 및 스크류 마모 심함	* 주조 압력을 높일 수 있어 두꺼운 중대형 부품 제조 가능 * 소모품이 저렴하고 교체가 간편 * 특정 소재에 종속되지 않고, 대량생산 적합

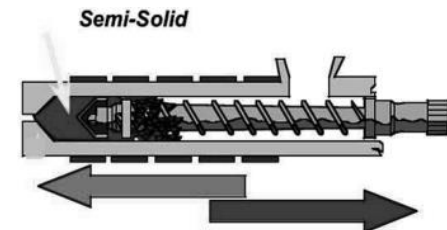
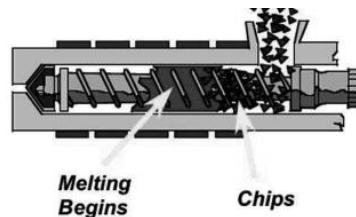
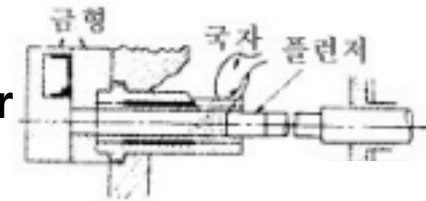
※ 2011.10월 한국마그네슘기술연구조합 자료 인용

Thixomolding



Cold chamber

(기존 KH바텍 설비)



KH VATEC®